

令和 07 年度 (後期) 技能検定 学科試験正解

半導体製品製造／集積回路組立て作業【1級】

真偽法

| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|---|---|
| 正解 | X | ○ | X | X | ○ |

| 番号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|----|
| 正解 | ○ | ○ | X | X | X |

| 番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----|----|----|----|----|
| 正解 | ○ | ○ | X | X | ○ |

| 番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----|----|----|----|----|----|
| 正解 | ○ | ○ | X | ○ | ○ |

| 番号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|----|----|----|----|----|----|
| 正解 | X | ○ | X | X | ○ |

択一法

| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|---|---|
| 正解 | イ | 口 | イ | ハ | ハ |

| 番号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|----|
| 正解 | ハ | ハ | 口 | イ | イ |

| 番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----|----|----|----|----|
| 正解 | 口 | イ | 口 | 口 | ニ |

| 番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----|----|----|----|----|----|
| 正解 | ハ | ハ | ニ | ニ | ニ |

| 番号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|----|----|----|----|----|----|
| 正解 | ニ | ニ | イ | ニ | ハ |